# **RF**マグネトロンスパッタ法による*ε*-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(001)層の エピタキシャル成長

# 渡邉 雅人 ((公財)電磁材料研究所)

# Epitaxial growth of ε-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(001) layer by RF magnetron sputtering Masato Watanabe (Research Institute for Electromagnetic Materials)

#### はじめに

 $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\epsilon$ ,  $\zeta \geq 5$ つある Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の多形体の一つである $\epsilon$ 相は, 斜方晶であり a 軸および b 軸方向にフェライトとしては強い結晶磁気異方性 (K<sub>a</sub> = 7.7 x 10<sup>6</sup> erg/cm<sup>3</sup>, K<sub>b</sub> = 1.2 x 10<sup>6</sup> erg/cm<sup>3</sup>)を持つ一方,フェリ磁性体のため飽和磁化は 1.26 kG と小さく,このため異方性定数と飽和磁化の比である異方性磁界は非常に大きくなる(154 kOe). その結果,高保磁力(20 kOe)と高共鳴周波数(182 GHz)が得られている.また,室温でマルチフェロ特性を有することも知られているため、ミリ波電磁波吸収材料,磁気記録媒体およびマルチフェロを利用したデバイスなどへの応用展開が期待されている.しかし、 $\epsilon$ 相は準安定相のため合成が困難であり、現状その合成方法のほとんどがナノ粒子の化学合成あるいはPLDによるエピタキシャル成長の二つに限られている.今回、薄膜合成として工業的応用上重要となる RF マグネトロンスパッタ法によりエピタキシャル $\epsilon$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>層の成長を試みたので、その結果について報告する.

#### 実験方法

800℃に加熱した SrTiO<sub>3</sub>(111)および YSZ(100)基板上に, α-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 焼結ターゲットを用い, Ar+O<sub>2</sub> 混合ガスを導入した反応性 RF マグネトロンスパッタ法により成膜を行った.構造は高分解能 XRD, HAADF-STEM および極微電子線回折で,磁気特性は VSM で評価を行った.

#### 実験結果

スパッタガス圧および Ar+O<sub>2</sub> スパッタガスの酸素流量比を変化 させた成膜を検討した結果,スパッタ放電限界に近い1mTorrの 低ガス圧および25%以上の高酸素ガス流量でc軸配向したE相が 生成することが XRD から確認された.低ガス圧ではスパッタ粒 子の平均運動エネルギーが高くなるため,高いスパッタ粒子エネ ルギー,高酸素濃度雰囲気,高基板温度がE相生成に必要と考え られる.Fig.1の断面 TEM 観察および極微電子線回折から, SrTiO<sub>3</sub>(111)基板上に膜厚 5 nm 程度のE相エピタキシャル層が生 成し,5 nm 以上の膜厚ではα相となることが確認された.一方 PLD によるE相エピタキシャル成長では,100 nm 程度の膜厚試料 が得られ,面内に3回対称の方位を持つ数 nm サイズの c 軸配向 ナノドメインからなる微細構造を持つことが報告されており<sup>1)</sup>, 今回のスパッタ法による試料とは異なる組織が得られている.ヒ ステリシスカーブは,磁気的にソフトな相とハードな相が混在し た特徴を示した.



Fig.1 Cross sectional HAADF-STEM image for  $\alpha/\epsilon$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> / SrTiO<sub>3</sub>(111) film. <sup>2)</sup>

## 参考文献

- 1) M. Gich et al., Appl. Phys. Lett., 96 (2010) 112508.
- 2) M. Watanabe, Determinations Nanomed Nanotechnol. 1 (2019) DNN.000502, arXiv:1903.01022.

# 反応性パルス DC スパッタリング成膜におけるターゲット中酸素濃度が

BiFeO3系薄膜の磁気・誘電特性へ及ぼす影響

◎山本 大地 , 吉村 哲

## (秋田大学)

Influence of oxygen concentration of sputtering target on the magnetic and dielectric properties of BiFeO3 based

thin films in reactive pulsed DC sputtering method

<sup>o</sup>D. Yamamoto, and S. Yoshimura (Akita Univ.)

**1. はじめに** 室温で反強磁性・強誘電性を有する BiFeO<sub>3</sub>の Bi<sup>3+</sup>や Fe<sup>3+</sup>を,適切な価数を有する元素で置換することで,強磁性が発現す ることが既に報告されている.我々は,反応性パルス DC スパッタ リング法を用いて作製した(Bi,La)(Fe,Co)O<sub>3</sub>薄膜において,電圧駆動 型磁気デバイス応用に有用な,比較的高い飽和磁化 *M*<sub>s</sub> (70 emu/cm<sup>3</sup>) かつ垂直磁気異方性を得ている<sup>1)</sup>.一方で,BiFeO<sub>3</sub>の誘電特性は試 料中の酸素空孔の存在量に大きく関わることが示唆されており<sup>2)</sup>, この低減もデバイス応用上重要なことである.本研究では,Bi の置 換元素にランタノイド系元素である Gd を選択し,酸素含有量の異な るターゲットを用いて作製した(Bi,Gd)(Fe,Co)O<sub>3</sub>(BGFCO)薄膜の磁気 および誘電特性を評価・比較することで、ターゲット素材を含めた成 膜条件が,その磁気および誘電特性に及ぼす影響を検討した.

2. 実験方法 (Bi<sub>0.45</sub>Gd<sub>0.55</sub>)(Fe,Co)O<sub>3</sub> 薄膜(200 nm)を,反応性パルス DC スパッタリング法を用いて,熱酸化膜付き Si 基板上に Ta(5 nm)/Pt(100 nm)の下地層を成膜した後,積層膜として作製した.積層 膜は,Ta を室温,Pt を 300℃,BGFCO を 695℃の基板温度で成膜した.スパッタリングターゲットには,Gd-Fe-O 粉末,Fe 粉末,Co 粉末を焼結させて作製した導電性ターゲットにBiシートを配置したものを用いた.使用したターゲットの組成は Fe<sub>9</sub>Co<sub>3</sub>Gd<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (GdFeO<sub>3</sub> 粉末使用:G1O3) と Fe<sub>13</sub>Co<sub>4</sub>Gd<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (Gd<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub>粉末使用:G1O4) の 2 種を用いた.反応性パルス DC スパッタリング法におけるパルス条件として,周波数を 100 kHz,電力は 150 W,ON:OFF 比は 3:2 の一定値とした.磁気測定は,振動試料型磁力計(VSM)により,誘電測定は,BGFCO積層膜の最表面にPtドット状電極 (\phi100 µm)を成膜した後に,強誘電体特性評価システムにより,それぞれ行った.

3. 結果 Fig.1 に,酸素含有量の異なる二つのターゲットを用いて 作製した BGFCO 薄膜の膜面内および垂直方向の *M*-*H* 曲線を示す.*M*s はどちらの薄膜試料でも 80 emu/cm<sup>3</sup> 程度の比較的高い値が得られた. 保磁力 *H*c に関しては G1O4 ターゲットを用いた方が小さい値を示し た.Fig.2 に,同薄膜試料の誘電特性を示す.G1O3 ターゲットを用 いて作製した薄膜試料では明瞭なヒステリシスが確認できなかった ことから,常誘電性を有していると思われるが,G1O4を用いた場合 の薄膜試料では原点対称性が良く明瞭なヒステリシスを有する *P*-*E* 曲線が得られていることから,良好な強誘電特性が得られたと言え る.使用ターゲットにより強誘電特性の違いが生じた要因として, G1O4 ターゲットを用いた,積極的に酸素を供給しながら成膜された試 料では,強誘電特性を劣化させる酸素空孔の発生が抑えられたたため であると考えられる.そして,その酸素空孔の低減が,外部磁場に対す



Fig.1 *M-H* curves of BGFCO films fabricated by the target of (a)G1O3 and (b)G1O4.





る磁壁移動を抑制するピンニングサイトの低減をもたらし、保磁力が小さくなったと考えられる.

参考文献 1) 吉村 第 42 回日本磁気学会学術講演概要集, 13aA-5.2) X. Qi et al., Appl. Phys. Lett., 86, 062903 (2005)

# 反応性パルス DC スパッタリング成膜における BiFeO3系強磁性・強誘電薄膜の高品位作製の指針

武田 航太朗, 吉村 哲 (秋田大)

#### Guidelines for fabrication of high quality multiferroic BiFeO<sub>3</sub> based thin films in pulsed DC reactive sputtering method K. Takeda, and S. Yoshimura

(Akita Univ.)

はじめに 強磁性・強誘電材料は、印加電界 E による磁化 M の方向制御、印加磁場 H による電気分極 P の方 向制御が可能とされているため、革新的な次世代電子材料として注目されている。本材料を電圧駆動型の磁 気デバイスに使用する場合,高信号出力化などの観点から高い飽和磁化 M。が求められる.以前,本研究グル ープではRFスパッタリング法を使用してBi<sub>1-x</sub>Ba<sub>x</sub>FeO<sub>3</sub>薄膜を作製していたが、その $M_x$ の最大値はBi<sub>1-x</sub>Ba<sub>x</sub>FeO<sub>3</sub> 粉末の M<sub>s</sub>の半分程度の 60 emu/cm<sup>3</sup>しか示さなかった.そこで、薄膜を高品位に作製するため、RF スパッタ リング法に代えて、反応性パルス DC(R-PDC)スパッタリング法 <sup>1)</sup>を用いて Bi<sub>1-x</sub>Ba<sub>x</sub>FeO<sub>3</sub>系薄膜の作製を試み た. R-PDC スパッタリング法では最大 92 emu/cm<sup>3</sup>となり, M<sub>5</sub>の大幅な向上が見られた. また, R-PDC スパ ッタリング法で作製した薄膜は、RFスパッタリング法で作製した薄膜に比べ、成膜速度は5倍程度、抵抗値 は 20 倍程度となり,他の特性に関しても大幅な向上が見られた<sup>2)</sup>.しかし, R-PDC スパッタリング法におけ る成膜条件として、一般的な成膜電力に加え、パルス周波数やターゲット素材なども存在し、これらと薄膜 の品質における相関は詳しくわかっていない.本研究では、R-PDCスパッタリング法で作製した薄膜の磁気 特性における,成膜電力依存,パルス周波数依存,ターゲット素材依存を明らかにすることを目的とした. <u>方法</u> R-PDC スパッタリング法を用いて,(Bi<sub>0.5</sub>Ba<sub>0.5</sub>)FeO<sub>3</sub>(BBFO)薄膜(膜厚 300 nm)を,熱酸化膜付き Si 基板 上に Ta(5 nm)/Pt(100 nm)の下地層を成膜した後,積層膜として作製した.積層膜は基板温度として,Ta を室 温, Pt を 300℃, BBFO を 695℃で成膜した. さらに, BBFO 薄膜のペロブスカイト構造の形成を促進させる ために、成膜時の薄膜に VHF プラズマ照射を施した. BBFO 薄膜の成膜には、Fe 粉末と Ba-Fe-O 粉末とを焼 結させて作製した,酸化物の含有量が異なる(導電特性が異なる)3種類のターゲットに,Biシートを配置 したものを用いた. R-PDC スパッタリング法におけるパルス条件として,周波数を 50~250 kHz,電力を 80 ~200Wの範囲で変化させた.作製したBBFO薄膜の組成分析は、エネルギー分散型X線分光器(EDS)によ

**結果** *M*<sub>s</sub>の成膜電力に対する変化は、Fig.1 に示すように、電力増大に伴い単調に増加し、200 W において 最大値 92 emu/cm<sup>3</sup>の高い値を示した. *M*<sub>s</sub>のパルス周波数に対する変化は、Fig.2 に示すように、周波数減少 に伴い単調に増加した. Fig.3 には、ターゲットに含まれる酸化物含有量の割合が 14, 17, 20 mol%で、導電特 性が異なるターゲット(Ox-14, Ox-17, Ox-20)を用いて作製した薄膜の、*M*<sub>s</sub>のターゲット中酸化物含有量依存 性を示す. 酸化物含有量が少ないほど、*M*<sub>s</sub>は高い値を示した. 以上の結果より、成膜電力が高く、パルス周 波数が低く、ターゲットの導電性が良いほど、より大きな *M*<sub>s</sub>を持つ強磁性・強誘電 BiFeO<sub>3</sub>系薄膜が作製でき ることがわかった. これは、アーク放電が抑制された R-PDC スパッタリング法では、高いエネルギーを有す るスパッタ粒子を離散的に基板に到達させることで、原子の基板表面拡散を促進させるためと考えられる.

<u>参考文献</u> 1) D. Pelleymounter et al., 2014 Soc. Vac. Coat., 57th Annual Technical Conference Proceedings, Chicago, USA. 2) 吉村哲, 第 42 回日本磁気学会学術講演概要集, 13aA-5.





り、磁気測定は、振動試料型磁力計(VSM)により行った.

Fig.2 Dependence of saturation magnetization of BBFO films on pulse frequency.

g.3 Dependence of saturation magnetization of BBFO films on oxygen content in target.

# ダイナミックオーロラ PLD 法を用いた Mn<sub>3</sub>CuN 薄膜の作製と評価

川口昂彦, 鈴木淳平, 坂元尚紀, 鈴木久男, 脇谷尚樹 (静岡大) Preparation and characterization of Mn<sub>3</sub>CuN thin films by Dynamic Aurora PLD T. Kawaguchi, J. Suzuki, N. Sakamoto, H. Suzuki, N. Wakiya (Shizuoka Univ.)

## <u>はじめに</u>

逆ペロブスカイト構造(B<sub>3</sub>AN)を持つ遷移金属窒化物は、負熱膨張や異常ホール効果の発現、超伝導体やハ ーフメタルといった興味深い特性を発現する物質群である。その中でも Mn<sub>3</sub>CuN は、約 150 K で強磁性転移 を示し、最大 2000 ppm に及ぶ巨大磁歪を示す。この系の薄膜作製には、従来研究ではマグネトロンスパッタ 法やプラズマ支援 MBE 法などが用いられている。すなわち窒化物相の形成のために、反応性の高い窒素プラ ズマを供給することが重要である。これらに対し、我々は成膜中に磁場印加が可能な、ダイナミックオーロ ラ PLD 法を独自に開発してきた。本手法ではプルームの再結合が磁場印加により抑制され、原料元素をイオ ンの状態で基板に供給することが出来る。すなわち、プラズマ化電源無しに窒化物ターゲットのアブレーシ ョンのみで窒素プラズマを供給できると考えられる。そこでダイナミックオーロラ PLD 法を用いて Mn<sub>3</sub>CuN 薄膜を作製したので報告する。

#### <u>実験方法</u>

Mn<sub>3</sub>CuN 薄膜は、ダイナミックオーロラ PLD 法を用いて MgO (001) 基板上に成長した。Nd:YAG レーザー4 倍波(266 nm)を用い、Mn<sub>2</sub>N-Cu 混合粉末を放電プラズマ焼結(SPS)した焼結体をターゲットに用いた。 到達真空度は 10<sup>-6</sup> Torr で成膜温度と印加磁場を成長条件として、膜 厚が 100 nm 程度となるよう成膜時間を調整した。得られた薄膜は、 X 線回折(XRD)、電子線マイクロアナライザ(EPMA)、透過型電子顕 微鏡(TEM)、四短針法による抵抗率測定および SQUID を用いた磁化 率測定などによって評価した。

#### <u>実験結果</u>

Fig. 1 に 500℃, 2000 G の条件で作製した Mn<sub>3</sub>CuN 薄膜の TEM によ る電子線回折像を示す。制限視野は薄膜だけでなく基板も含んでいる。 この結果から、得られた薄膜には Mn<sub>3</sub>CuN 相だけでなく、MnO 相お よび Cu 相が形成していることが分かる。これは、到達真空度が 10<sup>-6</sup> Torr 程度であるため成長チャンバ中の残留酸素が原因であると考え られる。興味深いことにいずれの回折点も方位が揃っており、すべて の相が MgO 上にエピタキシャル関係を保って形成していることがわ かる。このことから、残留酸素により Mn<sub>3</sub>CuN が酸化・分解するこ とで、MnO 相と Cu 相が形成したのではないかと推察される。

Fig. 2 にこの薄膜の磁化率測定の結果を示す。MnO 相や Cu 相は反 強磁性や常磁性であるため、150 K 付近で観測されている強磁性転移 は Mn<sub>3</sub>CuN 相のものであると考えられる。Mn<sub>3</sub>CuN 相に窒素欠損が存 在するとキュリー点が 150 K よりも上昇することが報告されている ため、この薄膜中の Mn<sub>3</sub>CuN 相には窒素欠損がほぼ無いことが期待 される。すなわち、ダイナミックオーロラ PLD 法での成膜により窒 化物相の十分な窒化が実現したと考えられる。



Fig. 1 TEM electron diffraction of Mn<sub>3</sub>CuN thin film grown on MgO substrate by Dynamic Aurora PLD.



Fig. 2 Temperature dependence of magnetization of the Mn<sub>3</sub>CuN thin film shown in Fig. 1.